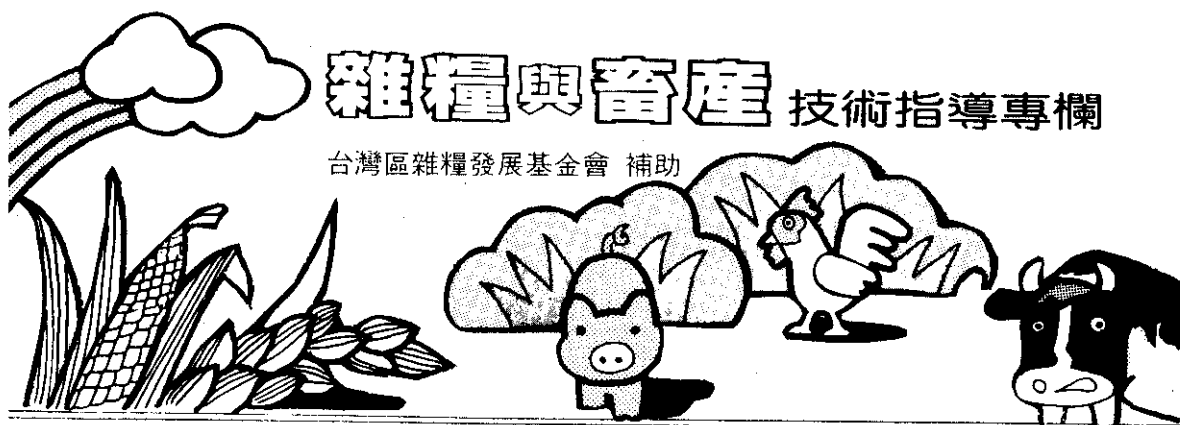




雜糧與畜產 技術指導專欄

台灣區雜糧發展基金會 補助

夏作優良的栽培方式

台南改良場
朴子分場主任 曾清田
／黃杉芪

宿根高粱

高粱適應性廣，再生能力強，因此春作高粱收成後，適合繼續留做宿根栽培。種植宿根高粱只須適時切除母莖，不用再整地播種，栽培成本低、操作簡便、生育日數短，不影響後作栽培。若生育期間加以適當的管理，產量不亞於主作栽培，所以宿根高粱是夏作理想的栽培作物之一。但為便於機械收穫、給水灌溉方便及減少鳥害發生，宿根高粱宜採用大面積集團栽培。

以下是夏作高粱宿根栽培應注意的事項，提供農友參考。

適時切莖疏芽

春作高粱收穫期頗長，從6月中旬至8月上旬。但在考慮不影響後作栽培情形下，7月中旬前收穫者才宜於留做宿根栽培。

母莖切除應於高粱收穫後一星期內進行。當田面尚濕潤時，用鐮刀或割草機將高粱殘莖貼着地面割斷，切莖高度勿高出地面2公分，以免節數過多，造成萌芽過量，增加疏芽的工作。隨即將割下的殘莖隔行直鋪蓋於畦溝中（春作高粱如採高畦栽培者，殘莖放於畦上）。在切莖時如土壤過於乾旱，應先灌水再切莖，如此可促進新芽成長，減少新芽枯死。切莖工作切勿過遲，以防母莖養分耗盡，不利新芽成長。

母莖切除後通常每株可長出2～5支新芽，若無



新芽長出後應適當疏芽，以免植株過密。

適當疏芽，則因植株過密，造成營養競爭，植株徒長及病蟲害滋生，以致果穗小，抽穗期、成熟期參差不齊，影響產量及品質至鉅。疏芽一般在芽高6～10公分時舉行，用鐮刀由基部將芽割除，每株留健芽1～2支為宜。

施肥量稍少於春作

夏季高溫多濕有利於肥料分解及作物吸收，宿根高粱肥料用量可稍少於春作栽培用量。肥料用量如附表所示。一般於切莖後8～10天施用基肥，基肥是將硫酸銨半量、過磷酸鈣 350公斤、氯化鉀全量混合一起施用。基肥施用時，需等葉面露水乾時施於離植株

切莖後25~30天施用追肥



10~15公分的地面處，並隔行輕度培土，使成兩行一畦，以利排水。在切莖後25~30天約芽高25~30公分時，施用追肥，促進生育。如使用複合肥料39號做基肥，每公頃用量350公斤，切莖後25~30天配合使用硝酸銨360公斤做追肥。

在切莖後如有雜草發生，應即進行除草。視雜草發生情形實施2~3次，除草工作可與追肥培土合併進行。

做好排水工作

宿根高粱栽培期間是本省夏季多雨季節，應做好排水工作，以免因浸水過久使根部腐爛，影响植株生育，或促進病虫害發生及延長成熟期。宿根高粱在幼穗形成期、抽穗期及乳熟期，如上壤過於乾旱仍應適當灌水，才可提高產量。

注意防治病虫害

夏作宿根高粱栽培期間高溫多濕，葉斑病、紋枯病發生常較春作嚴重。而黍蚜及穗夜蛾在宿根高粱後期發生亦頗嚴重。因此應做好病虫害防治工作，才可確保收成，病虫害防治要點如下：

1.葉斑病：於切莖及疏芽後應予噴施80%錳乃浦可濕性粉劑400倍，或65%鋅乃浦可濕性粉劑400倍，以抑制葉斑病蔓延，以後視發病情形施用1~2次。

夏作宿根高粱施肥量 (公斤/公頃)

肥料種類	公頃用量	基肥	追肥
硫酸銨	500~600	250~300	250~300
過磷酸鈣	400	350	50
氯化鉀	60	60	
複合肥料39號	350	350	每公頃硝酸銨 鈣 360公斤



夏季高溫多濕，容易發生紋枯病，應注意防治

2.紋枯病：發病初期施藥一次於發病部位，約2周後必要時再噴施一次。防治藥劑可用16.5%滅紋乳劑2,500倍，每公頃用量0.4~0.5公升，或65%鐵甲砒酸銨溶液2,000倍，每公頃用量0.4~0.5公升。若於抽穗後用藥時應避免噴灑到穗部，而影響稔實。

3.穗夜蛾：抽穗後開花初期噴射於穗部，約10天後必要時再噴一次。防治藥劑可用40.6%加保扶水懸粉800倍，每公頃用量1.1~1.5公斤，或以50%加保利可濕性粉劑500倍，每公頃用量1.1~1.5公斤。

4.黍蚜：發生時以下列任一種藥劑防治之。①90%納乃得可濕性粉劑3,000倍，每公頃用量0.3~0.4公斤。②24%納乃得溶液750倍，每公頃用量1.2~1.6公升。③75%歐殺松水溶性粉劑1,500倍，每公頃用量0.6~0.8公斤。④40.6%加保扶水懸粉800倍，每公頃用量1.2~1.5公斤。

調製期間應防驟雨

夏作高粱宿根栽培期間正值高溫，因此充實期較短，約抽穗後30~35天，莖葉變黃，子實堅硬且呈乳白色，即達成熟收穫適期。高粱可以聯合收穫機或人工收穫，收穫子實應即乾燥調製，乾燥期間如遇驟雨應注意收貯，以防子實被雨水浸濕，因子實一經吸水發芽，將使品質降低。如遇久雨可利用火力乾燥機進行。乾燥宿根高粱應適時收穫，切勿延遲，以免延誤後作的播種工作。